



Versatz / displacement	Toleranz / tolerance
Fräskante zu Bohrung / milled edge to holes	±0,2
Fräskante zu Leiterbild / milled edge to conductiv pattern	±0,3
Bohrungen / holes	±0,1
Bohrungen zu Leiterbild / holes to conductive pattern	±0,15

- 1) Leiterplatten Gesamtdicke mit Leiterbahnen und Lötstopplack
PC board total thickness with conductor paths and solder resist
 - 2) maximale Bauteilhöhe: max 2,00mm
maximal component height: max 2,00mm
 - 3) Toleranz für Bohrungsabstand (2,00±0,05): 21,15±0,1
tolerance for hole pitch (2,00±0,05): 21,15±0,1
 - 4) Toleranz für Frässteg (Trennkante) : max 0,2
tolerance for milling bridge (break bridge) : max 0,2
- Toleranz für Kupferstrukturen ±0,127mm
tolerance for copper structures ±0,127mm
- Alle Maße in mm
all dimensions in mm

- Goldkontaktfläche
contact surface gold
- Goldfläche
surface gold
- Sperfläche für Kontaktflächen
blocked contact surface
- Sperfläche für Bauteile (Bauteile können bis an Sperfläche angrenzen)
blocked surface for components (components can boarder on blocked surfaces)
- Sperfläche für Bauteile und Gehäuseabstützung (Antennenfläche)
blocked surface for components and support for housing (antenna surface)

Freimaße DIN 7168 m		Maßstab: 8:1	DIN A2
Material:		Leiterplatte PTM 535BZ PC board PTM 535BZ	
Blatt: 1-1		EnOcean C99-L01	
5	erstellt / created	02.03.2021	JBo
Zust.	Mitteilung	Datum	Name